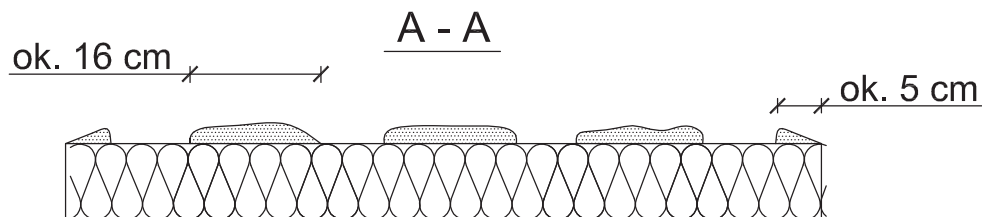
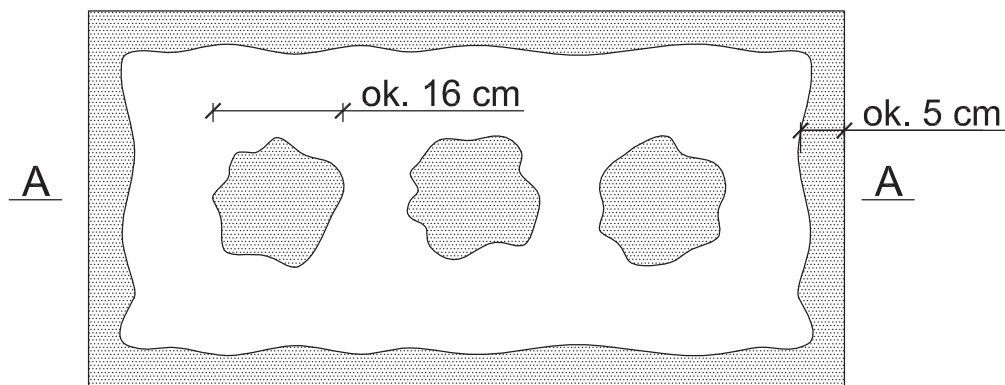
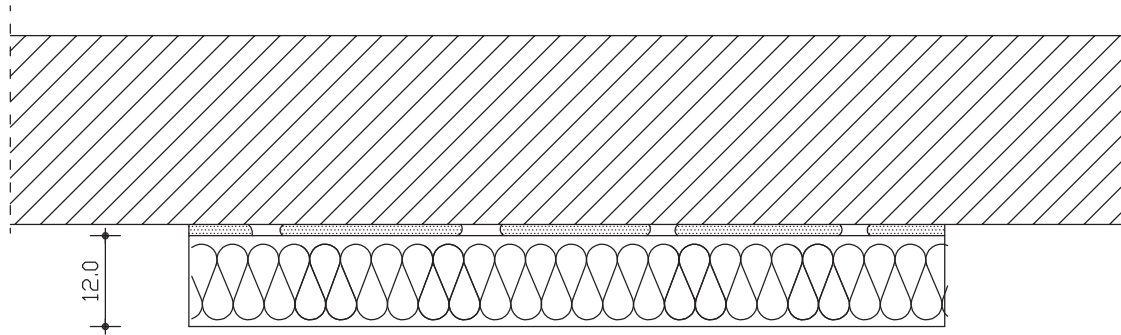


# Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej.



Do klejenia izolacji termicznej używa się fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podłoża nienasiąkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Zaprawę klejową należy przygotowywać według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne) również w przypadku fabrycznie przygotowanych klejów dyspersyjnych, które wymagają zmieszania z cementem celem przygotowania właściwej zaprawy klejowej.

Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody obwodowo-punktowej.

Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40 % efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji).

Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płytę termoizolacyjną całopowierzchniowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10 mm).

$$\frac{P_e}{P} \times 100 \% \geq 40 \%$$

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia płyty termoizolacyjnej do podłoża

P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej przylegająca do ściany

INWESTYCJA: REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY w PŁOŚNICY			
PŁOŚNICA ul. Dworcowa 52 działka nr 299/7			
INWESTOR: <b>URZĄD GMINY PŁOŚNICA</b>			
FAZA: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>			
DATA: <b>2.06.2013 r.</b>			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Henryka Zawadzka	1438/59	
PROJEKTANT:	inż. Wojciech Błaszczyk	Cie 45/90	
TRESC RYSUNKU: Sposób klejenia styropianowych płyt izolacji termicznej.		SKALA: 1:10	NR. RYS.: